

# HALBAUTOMATISCHES SELEKTIVLÖTGERÄT ONYX 24

GERÄTE

4.104



EINSATZBEREICH: SMT

MODELLREIHE: ONYX

Die vollständige Dokumentation  
der ONYX-Modellreihe besteht

aus den folgenden Datenblättern:

GERÄTE 4.101 - 4.104

ZUBEHÖR 2.201, 2.202

OPTIONEN 4.301 - 4.302



NEU

- Kraftmessung
- 2000 W Oberheizung
- 3500 W Unterheizung



**EINSATZBEREICH**

ZUM SELEKTIVEN EIN- UND AUSLÖTEN VON SMD-BAUTEILEN. AUSGERÜSTET MIT EINEM SPEZIELLEN VISION-SYSTEM FÜR HÖCHSTPRÄZISE AUSRICHTUNG VON ALLEN SMD- UND FINE PITCH-BAUTEILEN, BIETET DAS ONYX 24 EIN HOHES MASS AN SICHERHEIT UND BEDIENUNGSKOMFORT. ES EIGNET SICH VOR ALLEM FÜR:

**Reparaturen**

Schlecht platzierte Bauelemente können exakt positioniert, defekte Bauelemente ausgetauscht werden.

**Prototypenbau**

Prototypen von Leiterplatten können mit dem ONYX 24 auf rationelle Art bestückt und gelötet werden.

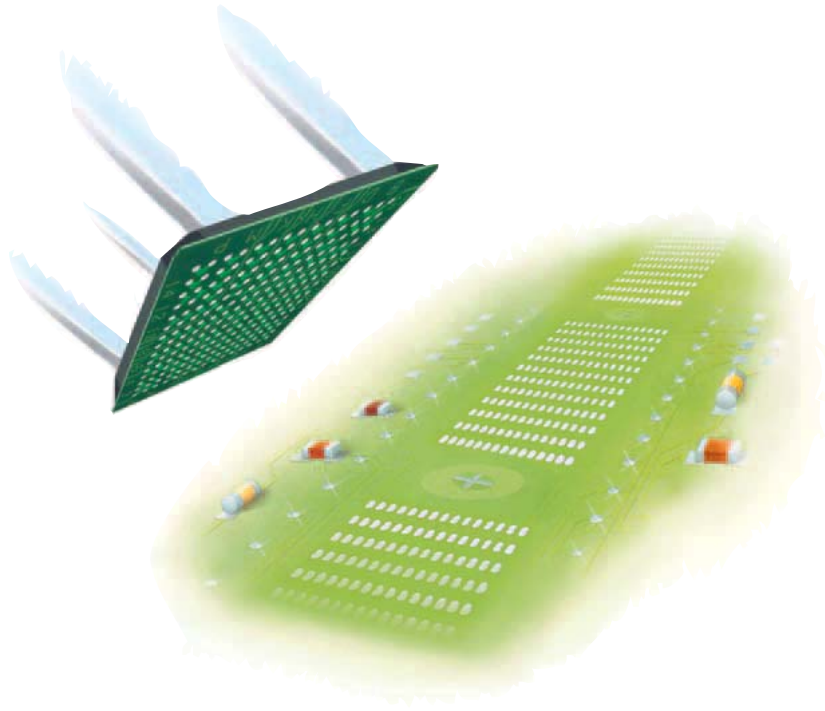
Teure Bauelemente können wiederverwendet werden.

**Nachbestückung**

Bauelemente, welche zur Zeit der Produktion fehlen, können nachträglich bestückt und gelötet werden. Auch einzelne Bauelemente, die mit den vorhandenen Produktionsautomaten nicht verarbeitbar sind, können nachträglich bestückt und gelötet werden.

**Bestückung**

Sind Leiterplatten mit nur wenigen Bauelementen zu bestücken, dann ist in vielen Fällen der Einsatz des Ein- und Auslötgerätes ONYX 24 die wirtschaftlichste Lösung.

**MARKTANFORDERUNGEN**

DIE RASANTE ENTWICKLUNG DER SMT FORDERT FÜR DIE HANDHABUNG EINZELNER SMD's IMMER MEHR PROFESSIONALITÄT. IMMER KOMPLEXERE BAUELEMENTE MÜSSEN IMMER PRÄZISER PLATZIERT WERDEN. IMMER WERTVOLLERE LEITERPLATTEN MÜSSEN IMMER SORGFÄLTIGER BEARBEITET WERDEN. ZEVAC ONYX 24 WIRD DIESEN ANFORDERUNGEN IN BESONDERER WEISE GERECHT:

**Höchste Präzision, reproduzierbare Resultate**

Aufnahme der Leiterplatten und Feinverstellung in X, Y, und Theta-Achse. Die Leiterplatte wird mittels mechanischer Blockierung in Position gehalten. Zentrierung des Bauelementes in der SMD-gehäusekonformen Düse. Die Düsen sind so konstruiert, dass Bauelement und Leiterplatte beim Lötprozess geschützt sind. Präzise Steuerung der Wärmemenge (Durchfluss x Temperatur x Zeit).

**Bedienungskomfort, Verfügbarkeit**

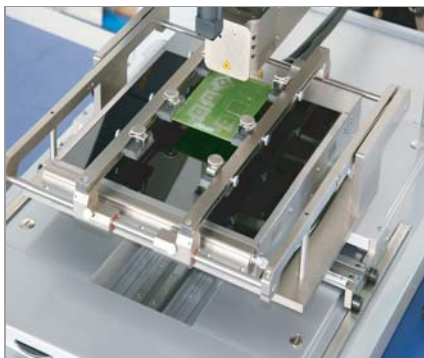
Ergonomisches Design. Rascher, unkomplizierter Düsenwechsel. Kurze Aufheizzeit mit leistungsstarkem, effektivem Heizsystem. Über 100 verschiedene Standard-Düsen sind ab Lager verfügbar. Alle weiteren Sonder-Düsen sind kurzfristig lieferbar (Zubehör-Datenblätter 2.201 + 2.202).



**ONYX 24:**

Höchste Präzision mit halbautomatischer Prozesssteuerung:

- 1 Leiterplatte
- 2 Kreuztisch mit Feineinstellung
- 3 Heissgasdüse
- 4 2000 W Oberheizung
- 5 Beleuchtung
- 6 MFOV VISION
- 7 4 Thermoelement-Anschlüsse
- 8 Flachbildschirm
- 9 Basissockel
- 10 Leiterplattenkühlung
- 11 Printhalter
- 12 Vorwärmer
- 13 Heizkopfwinkelerstellung



**IR-VORWÄRMERSYSTEM**  
Für Bleifrei-Anwendungen

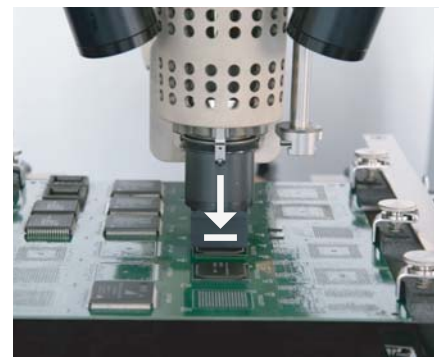
Vorwärmer 300 x 300 mm  
3500 W  
Leiterplattenkühlung als Option für schnelleres abkühlen erhältlich.



**VISION (MFOV)**  
Superpräzise Positionierung garantiert

Durch das motorisierte VISION-System können Bauelement und Layout-konfiguration optisch übereinander gebracht und auf alle 4 Seiten ausgerichtet werden. Die LED-Beleuchtung, eine für das Bauelement und eine für die Leiterplattenoberfläche, garantiert eine optimale Sicht unabhängig von der Umgebung.

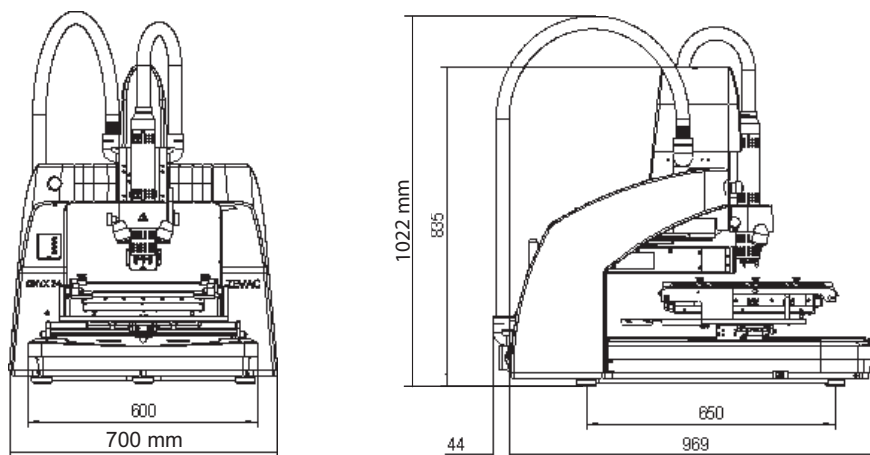
- 1 VISION-System  
Für Bauelemente bis 75 mm
- 2 LED-Beleuchtung



**KRAFTMESSUNG**  
Präzise, motorisierte Kraftmessung

Die Z-Achse ist motorisiert und platziert das Bauelement automatisch auf die Leiterplattenoberfläche mit Kraftunterstützung im Gramm-Bereich.

<b>Technische Daten</b>	Typenbezeichnung	ONYX 24
	Max. Leiterplatten-Abmessung	300 mm Breite, Tiefe unlimitiert
	Max. Bauelementhöhe	20 mm unten (30 mm als Option) 30 mm oben (70 mm als Option)
	Druckluftanschluss	4 - 6 bar 100l/min
	Heizkopfwinkelverstellung	± 10°
	Medium zur Wärmeübertragung	Gas (Druckluft, Stickstoff)
	Anschlussspannung	2300 W + 3500 W (Vorwärmermodul)
	Elektr. Anschlusswert	3 x 400 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
	Abmessungen (L x B x H)	1120 x 700 x 1022 mm
	Gewicht	120 kg (Basisgerät)
	Max. Bauelementgröße	75 x 75 mm (Standard)
	Technische Änderungen vorbehalten	

**Abmessungen**

<b>Zubehör</b>	Heissgasdüsen	Data sheet 2.201
	Gasdüsen für BGA- und CSP-Bauelemente	Data sheet 2.202
<b>Optionen</b>	Optionen - Restlotentfernung - Leiterplattenkühlung - IR-Sensor - Bauelementaufnahme - Direktsicht-Kamerasystem - Lotrauchabsaugung	Data sheet 4.302

**ZEVAC-Vertretung****ZEVAC**

ZEVAC AG  
Vogelherdstrasse 4  
CH - 4500 Solothurn / Schweiz

Telefon +41 / 32 626 20 80  
Fax +41 / 32 626 20 90  
E-mail [info@zevac.ch](mailto:info@zevac.ch)  
Website [www.zevac.ch](http://www.zevac.ch)